



平成 29 年5月期 第 3 四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成 29 年3月 31 日

上場会社名 三益半導体工業株式会社 上場取引所 東
 コード番号 8155 URL <http://www.mimasu.co.jp/>
 代表者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 中澤 正幸
 問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役管理本部担当 (氏名) 八高 達郎 (TEL) 027-372-2011
 四半期報告書提出予定日 平成 29 年4月 14 日 配当支払開始予定日 —
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成 29 年5月期第3四半期の業績(平成 28 年6月 1 日～平成 29 年2月 28 日)

(1) 経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
29 年5月期第3四半期	45,786	11.3	2,976	2.6	2,919	5.8	1,975	3.9
28 年5月期第3四半期	41,132	13.9	2,901	28.6	2,758	6.1	1,901	23.2

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
29 年5月期第3四半期	61.49	—
28 年5月期第3四半期	57.84	—

(2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
29 年5月期第3四半期	77,537	55,173	71.2
28 年5月期	76,775	53,923	70.2

(参考)自己資本 29 年5月期第3四半期 55,173 百万円 28 年5月期 53,923 百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
28 年5月期	—	13.00	—	13.00	26.00
29 年5月期	—	13.00	—		
29 年5月期(予想)				13.00	26.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成 29 年5月期の業績予想(平成 28 年6月 1 日～平成 29 年5月 31 日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通 期	57,000	1.2	3,500	0.6	3,400	2.8	2,250	2.0	70.03

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 無

④ 修正再表示 : 無

(注) 詳細は【添付資料】3ページ「(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(3) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)

29年5月期3Q	35,497,183株	28年5月期	35,497,183株
----------	-------------	--------	-------------

② 期末自己株式数

29年5月期3Q	3,368,594株	28年5月期	3,368,350株
----------	------------	--------	------------

③ 期中平均株式数(四半期累計)

29年5月期3Q	32,128,716株	28年5月期3Q	32,879,889株
----------	-------------	----------	-------------

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手している情報及び合理的であると判断する前提に基づいたものであり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信【添付資料】2ページ「(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	3
(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
3. 四半期財務諸表	4
(1) 四半期貸借対照表	4
(2) 四半期損益計算書	6
(3) 四半期財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
(セグメント情報)	7

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善を背景に個人消費が底堅く推移するなど、全体として緩やかな回復基調が継続いたしました。

半導体シリコンウエハーは、好調なメモリデバイス向けの需要に加え、ロジックデバイス向けの需要も堅調なことから、生産は高水準で推移いたしました。

このような経営環境の中で当社は、最先端加工技術の推進と低コスト化の両立を図るとともに、自社開発製品の拡販を積極的に進めるなど、総力を挙げて業績の向上に取り組みました。

この結果、当第3四半期累計期間の売上高は457億8千6百万円と前年同四半期比11.3%の増収となり、営業利益は29億7千6百万円（前年同四半期比2.6%増）、経常利益は29億1千9百万円（同5.8%増）、四半期純利益は19億7千5百万円（同3.9%増）となりました。

半導体事業部

当事業部におきましては、主力の300mmウエハーを中心として、高水準の生産を継続いたしました。そうした中で、更なる生産性の向上と原価低減を推進いたしました。

産商事業部

当事業部は自社開発製品及びその他の取扱商品の拡販活動に積極的に取り組みました。この結果、その他の取扱商品において増収となりました。

エンジニアリング事業部

当事業部は開発部門としての役割に特化し、自社製品の開発を積極的に行い、産商事業部を通じて販売いたしました。

また、半導体事業部で使用する装置の開発や設計・製作にも意欲的に取り組みました。

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期会計期間末における総資産は、現金及び預金の増加等により、前事業年度末と比較して7億6千2百万円増加し、775億3千7百万円となりました。一方、負債合計は仕入債務の減少等により4億8千8百万円減少し、223億6千3百万円となりました。純資産合計は利益剰余金の増加11億8千9百万円等により、551億7千3百万円となりました。

(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、平成28年7月15日の「平成28年5月期 決算短信」で公表いたしました業績予想に変更はございません。

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計方針の変更)

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日。以下「回収可能性適用指針」という。）を第1四半期会計期間から適用し、繰延税金資産の回収可能性に関する会計処理の方法の一部を見直しております。

回収可能性適用指針の適用については、回収可能性適用指針第49項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首時点において回収可能性適用指針第49項(3)①から③に該当する定めを適用した場合の繰延税金資産及び繰延税金負債の額と、前事業年度末の繰延税金資産及び繰延税金負債の額との差額を、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加算しております。

これによる四半期財務諸表に与える影響は軽微であります。

3. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成28年5月31日)	当第3四半期会計期間 (平成29年2月28日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	22,224	25,078
受取手形及び売掛金	21,376	22,043
商品及び製品	2,339	191
仕掛品	455	283
原材料及び貯蔵品	1,822	1,557
その他	1,294	1,129
貸倒引当金	△3	△9
流動資産合計	49,509	50,274
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	11,282	10,697
その他(純額)	13,124	13,625
有形固定資産合計	24,407	24,323
無形固定資産	548	509
投資その他の資産		
その他	2,315	2,435
貸倒引当金	△6	△5
投資その他の資産合計	2,309	2,429
固定資産合計	27,265	27,263
資産合計	76,775	77,537
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	15,770	14,741
短期借入金	100	100
未払法人税等	263	619
引当金	60	434
その他	3,881	3,376
流動負債合計	20,076	19,272
固定負債		
長期借入金	400	325
退職給付引当金	1,743	1,675
その他	632	1,091
固定負債合計	2,776	3,091
負債合計	22,852	22,363

(単位:百万円)

	前事業年度 (平成28年5月31日)	当第3四半期会計期間 (平成29年2月28日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	18,824	18,824
資本剰余金	18,778	18,778
利益剰余金	21,029	22,219
自己株式	△4,762	△4,762
株主資本合計	53,869	55,058
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	53	106
繰延ヘッジ損益	—	8
評価・換算差額等合計	53	115
純資産合計	53,923	55,173
負債純資産合計	76,775	77,537

(2) 四半期損益計算書
(第3四半期累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期累計期間 (自平成27年6月1日 至平成28年2月29日)	当第3四半期累計期間 (自平成28年6月1日 至平成29年2月28日)
売上高	41,132	45,786
売上原価	36,340	40,591
売上総利益	4,792	5,195
販売費及び一般管理費	1,890	2,219
営業利益	2,901	2,976
営業外収益		
受取利息	8	3
受取配当金	6	8
その他	23	23
営業外収益合計	38	34
営業外費用		
支払利息	0	0
為替差損	158	89
その他	22	0
営業外費用合計	181	90
経常利益	2,758	2,919
特別利益		
固定資産売却益	1	17
受取保険金	14	38
特別利益合計	16	55
特別損失		
固定資産売却損	0	—
固定資産除却損	29	18
減損損失	—	11
その他	19	49
特別損失合計	48	79
税引前四半期純利益	2,725	2,896
法人税、住民税及び事業税	467	804
法人税等調整額	356	116
法人税等合計	824	920
四半期純利益	1,901	1,975

(3) 四半期財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報)

報告セグメントごとの売上高に関する情報
前第3四半期累計期間 (自 平成27年6月1日 至 平成28年2月29日)

(単位：百万円)

	報告セグメント				調整額	四半期 損益計算書 計上額
	半導体事業部	産商事業部	エンジニア リング事業部	計		
売上高						
外部顧客への売上高	17,253	23,879	—	41,132	—	41,132
セグメント間の内部売上高 又は振替高	1	—	1,791	1,793	△1,793	—
合計	17,255	23,879	1,791	42,925	△1,793	41,132

当第3四半期累計期間 (自 平成28年6月1日 至 平成29年2月28日)

(単位：百万円)

	報告セグメント				調整額	四半期 損益計算書 計上額
	半導体事業部	産商事業部	エンジニア リング事業部	計		
売上高						
外部顧客への売上高	18,135	27,651	—	45,786	—	45,786
セグメント間の内部売上高 又は振替高	3	—	1,907	1,910	△1,910	—
合計	18,139	27,651	1,907	47,697	△1,910	45,786